

REMIX®

# MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK

## R550 ÁLLANDÓ ÉRTÉKŰ KISTELJESÍTMÉNYŰ MORZSA ELLENÁLLÁS

Termékszabvány száma:  
RX—74.401/4  
Minősítési szint: E  
Stabilitási osztály: 10%

### Szerkezeti felépítés

Kerámia hordozó,  
cermet réteg,  
éleken fémezve,  
nem szigetelt.

### Ajánlott felhasználás

Nyomatott huzalozású és  
felületszereléshez (SM)

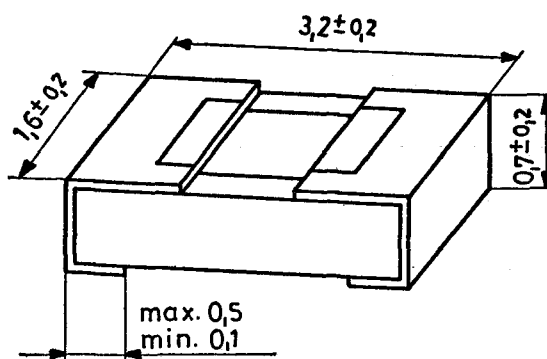
### Alapjellemzők

NÉVLEGES REZISZTENCIA	10 Ω...1 MΩ és 0 Ω (R < 50 mΩ, I <sub>max</sub> = 2 A határértékek mellett)
REZISZTENCIA SOR	E24
REZISZTENCIA TŰRÉS	±5, 10, 20%
NÉVLEGES TERHELHETŐSÉG	0,125 W
HATÁRFESZŰLTÉS	200 V
KÖRNYEZETÁLLÓSÁGI KULCSSZÁM	55/125/56
REZISZTENCIA VÁLTOZÁS	
hosszú idejű igénybevételnél (h)	±(10% + 0,5 Ω)
rövid idejű igénybevételnél (r)	±(2% + 0,1 Ω)

### Felhasználási, beszerelési előírás

- Nyomatott huzalozási lemezre:  
flow-solder és reflow-solder.
- Kerámia hordozóra: reflow-solder.

Méreték mm-ben



- a) Áramköri hordozó lemezre (nyomatott huzalozás) rögzítéssel (ragasztás), majd a forrasztást hullám-fürdőn (flow-solder) elvégezve.

— Forrasztásnál a folyasztó szer összetétele:

25% fenyőgyanta:	
savszám (mg KOH/g)	min. 155
lágypont	min. 70 °C
folyáspont	min. 76 °C
hamutartalom	max. 0,05 %
75% izopropil alkohol:	min. 99,5%
savtartalom	max. 0,002%
nem illó anyag	max. 2 mg/100 ml
vagy etilalkohol:	min. 96,2%
szabad sav	max. 4 mg/l

— Forrasztási hőmérséklet 250 °C

— Forrasztási idő 5 s

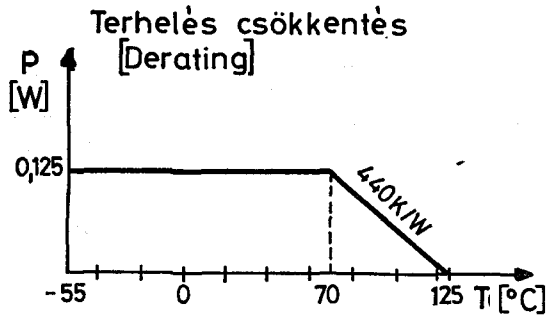
- b) A forrasztópaszta előzetes felvitelével és újra-folyasztásával (reflow-solder).

— Forrasztási hőmérséklet 215—260 °C

— Forrasztási idő 10 s

# Rezisztencia hőmérséklet függése

Néveleges rezisztencia	$\alpha$ $10^{-6}/K$	$\Delta R/R$		
		+20 ... -55°C	+20 ... +70°C	+20 ... +125°C
$\leq 100 \text{ k}\Omega$	$\pm 250$	$\pm 1,88$	$\pm 1,25$	$\pm 2,62$
$> 100 \text{ k}\Omega$	$\pm 500$	$\pm 3,75$	$\pm 25$	$\pm 525$



Ehelyezési variációk	$F_{min.}$ [mm]
	2,8
	5,4
	4,1

## Csomagolás

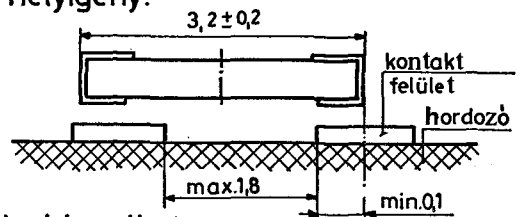
- Műanyag zacskóba, ömlesztve.
- Hevederéssel IEC 286-3 ... HD (MSZ kidolgozás alatt)
- Műanyag tárba rendezve ... kidolgozás alatt

## Megjegyzés:

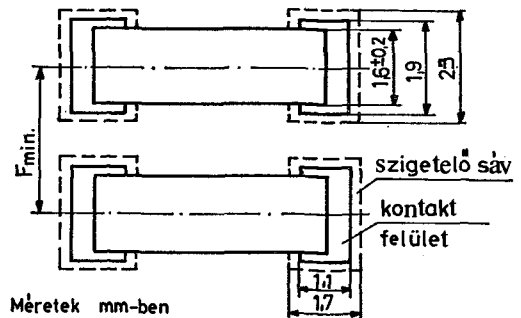
Ha rendelésnél a csomagolás módját nem tünteti fel, akkor az 1. alatti csomagolással szállítjuk.

## Felhasználási tájékoztató chip beültetésre

A kontakt felületek közötti helyigény:



A chip alkat-  
részek közötti helyigény:



## Rendelésnél megadandók

- katalógusjel
- néveleges rezisztencia és tűrés
- csomagolás módja
- a szabvány száma

## Rendelési példa:

R550 10 $\Omega$   $\pm$  5% HD RX—74.401/4

Bagossy Gábor

Megkeresésükre küldünk katalógust. Kereskedelmi főosztályunk várja érdeklődésüket és készséggel áll rendelkezésükre.



RÁDIÓTECHNIKAI VÁLLALAT Bp. X., Pataky tér 20.  
H—1475 Bp. 10. Pf. 64. Tel.: 573-033. Telex: 22-4565